

受託基板加工サービス -難加工材 GaN・SiC・AlN向け-

1. 基板加工サービス

GaN、SiC、AlNなどの難加工材基板加工サービス

- ・ As-grown・As-sliced・As-lapped基板の仕上げ研磨
- ・ 基板上に成長した膜の除去・仕上げ研磨（リクレーム）



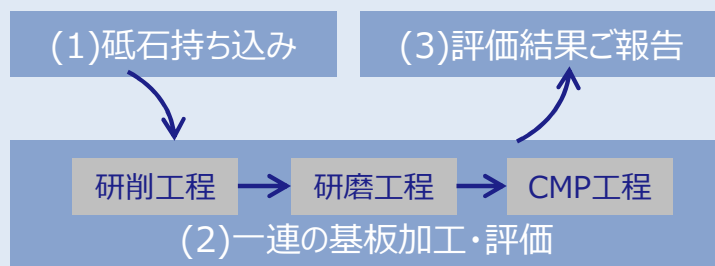
研磨基板
(GaN、SiC、サファイア)

2. 基板加工工程開発支援

研削加工・研磨加工の副資材や装置などの開発技術の評価し、加工工程開発を支援します。

評価の一例 -研削砥石の場合-

- (1) お客様が研削砥石を三桜に持ち込み
- (2) 三桜が最終工程まで基板加工・評価
- (3) 評価結果をお客様にご報告



3. GaN基板リサイクルのためのソリューション提案

特殊デバイス剥離技術や基板リサイクルのための基板研磨サービスを提供し、GaN基板のコスト削減に貢献します。

以下の受託基板加工サービスに対応いたします。

- 主な取扱業務
 - ・ 基板加工・・・基板の平坦化、鏡面研磨、エッジ加工
 - ・ リクレーム・・・膜の除去、鏡面研磨
 - ・ 基板加工工程開発支援
 - ・ GaN基板リサイクルのためのソリューション提案
- 対応可能材料
GaN、AlN、SiC、サファイアなど
- 対応可能基板サイズ
～2インチφ基板（角基板も対応可能）

**GaN・SiC・AlNなどの
基板加工でお困りの方
まずはご相談ください！**